

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

江苏艾森半导体材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-010

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 电话会议 ☐ 其他
参与单位名称	中泰证券、天风证券、顶天投资、华西证券、华创证券
时间	2025 年 11 月 3 日-11 月 6 日
地点	公司
上市公司接待人员姓名	董事长：张兵 总经理：向文胜 常务副总经理、董事会秘书：陈小华 合规总监：李珮媛 证券事务代表：徐雯
投资者关系活动主要内容介绍	问题一：简要介绍一下公司在各产品应用领域处于什么地位？ 答：公司作为国内先进封装及晶圆制造领域电子化学品的核心供应商，凭借深厚的技术积累和领先的市场布局，确立了显著的行业竞争优势。在先进封装领域，公司能够提供电镀、光刻整体解决方案，电镀铜、电镀锡银等电镀产品均已量产，同时多型号光刻胶产品取得突破，是先进封装光刻胶主力供应商。在晶圆制造领域，公司的电镀液产品处于行业第一梯队，先进制程节点的电镀液已取得量产订单。并针对多型

	号特色光刻胶进行差异化研发布局，以满足高端制造需求。此外，公司积极推动泛半导体行业技术迭代，产品线全面覆盖 PCB、类载板、IC 载板等多个应用场景。 问题二：公司在存储领域的产品进展如何？ 答：公司在存储芯片领域的产品布局以电镀液与光刻胶为核心，覆盖关键环节：电镀液产品包括 28nm 大马士革镀铜添加剂、TSV（硅通孔）高速镀铜添加剂，光刻胶产品涵盖负性光刻胶及 PSPI 光刻胶等产品。在目前国产化加速背景下，公司持续推进在国内头部存储客户的技术交流与产品验证。存储芯片产能扩张或将拉动材料需求量，尤其在 HBM、3DNAND 等先进存储技术领域，公司凭借“电镀+光刻”双工艺协同，有望持续受益于国产替代趋势。 问题三：公司毛利率的提升路径。 答：公司 2025 年前三季度毛利率为 28.57%，同比提升 2.29 个百分点，主要受益于公司核心技术突破和产品结构优化。公司将聚焦电镀液、光刻胶等半导体材料在 28nm 及以下制程、先进封装等高端领域的应用。随着晶圆制造与先进封装领域产品和业务的不断突破，公司高毛利产品收入占比逐步提升，将驱动毛利率稳步上行。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	无
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 11 月 6 日